

无铅无卤 阿尔法助焊剂 SLS65 SLS65C

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 无铅无卤 阿尔法助焊剂 SLS65 SLS65C |
| 公司名称 | 东莞市博焊电子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 锡条: 型号:SLS65/SLS65C 品牌:阿尔法ALPHA |
| 公司地址 | 东莞市万江区新城社区江滨花园第一期商业写字楼二楼A45号 |
| 联系电话 | 86-076922708845 13809828221 |

产品详情

alpha® sls 65c免清洗助焊剂alpha® sls 65c助焊剂是为了消除焊球形成和焊料桥连这两种晶片波常见缺陷而专门开发的。在所有低固含量（固含量小于4%）、免清洗助焊剂中，alpha® sls 65c在各种阻焊层上都表现出最低的焊球形成率。对于焊料桥连敏感的板片设计或者是需要进行表现针测性的测试以及对于低焊球形成率要求极高的应用，alpha® sls 65c都是理想的选择。概述alpha® sls 65c是一个高活性、低固含量、免清洗助焊剂，采用专有有机活化混合物配方。alpha® sls 65c中添加的一些专有添加剂能降低阻焊层和焊料之间的表面张力，从而显著地降低焊球形成几率。alpha® sls 65c配方也具有更佳的热稳定性，从而减少焊料桥连的产生。特性与优点

- 热稳定的活性剂能降低低固含量免清洗助焊剂的焊料桥连产生率。
- 降低了焊料和阻焊层之间的表面张力，可以抑制焊球的形成。
- 极低的非粘性残留物水平降低了对针测性测试的干扰，并且不会产生明显的残留物。
- 无清洗需求，从而降低运营成本。
- 长时间电可靠性符合bellcore标准。应用指导准备：为了保持焊接性能和电可靠性的稳定性，电路板和元件能在工艺开始时就能在焊接性和离子清洁性方面符合既定要求是非常重要的。我们建议组装厂商应该在這些項目上為其供應商建立规范要求，供應商在运输时也应提供分析证书并由组装厂商进行来料检验。来料板片和元件在离子清洁性方面的常见规范要求是不超过5 µg/in²（使用离子污染测试仪在加热溶液中测量）。电路板在整个工艺过程中都应该小心处理。只能握住板片的边缘。我们建议佩带清洁的无绒手套。当从一种助焊剂切换到另一种助焊剂时，建议使用新的泡沫石（进行泡沫助焊剂）。传送带、手指和托盘应保持清洁。bioact sc-10清洗剂对于这些应用场合的清洗非常有用。对于泡沫助焊剂，不要使用热的固定装置或托盘，否则会损坏泡沫喷雾头。助焊剂应用-alpha® sls 65c适用于泡沫、波峰或喷雾等方法。在泡沫焊接时，焊剂涂敷器应配备不含油或水的压缩空气。时刻让助焊剂槽处于装满状态。助焊剂应保持在高于泡沫石1-1-½英寸的位置。调节气压以精细一致的泡沫喷雾头来产生最佳的泡沫高度和细腻统一的泡沫喷雾。

均匀的助焊剂涂层对于成功焊接至关重要。在泡沫或波峰应用的场合，建议在助焊剂操作后使用空气刮刀。空气刮刀有助于确保助焊剂能均匀地分布在整個板片上并去除多余的助焊剂。在喷雾焊接时，如果

要用视觉检查涂层的均匀程度，可以将一块纸板放在喷雾焊剂涂敷器上或者是板片大小的钢化玻璃通过喷雾部分后再通过预热部分。机器设置的应用指南运行参数典型水平助焊剂用量泡沫，波峰焊接：1,000 - 1,500 $\mu\text{g}/\text{in}^2$ (固体) 喷雾焊接：450 - 800 $\mu\text{g}/\text{in}^2$ (固体) 泡沫焊接时:泡沫石小孔尺寸20 - 50 μm 泡沫石顶部距离助焊剂液面的高度1 - 1½ 英寸 (25 - 40 mm) 泡沫焊剂涂敷器烟道开口3/8 - 1/2英寸 (10-13 mm) 泡沫焊接并使用空气刮刀:空气刮刀孔直径1 - 1.5 mm通孔间距4 - 5 mm焊剂涂敷器和空气刮刀之间的距离4 - 6 英寸 (10-15 cm) 空气刮刀背侧与焊剂涂敷器垂直方向上的夹角3° - 5° 顶部预热温度210° f – 250° f (100° c - 120° c) 底部预热温度比顶部大约高65° f (35° c) 顶部温度的最大升温速度 (避免元件损坏) 不超过2° c/秒 (3.5° f/秒) 传送带角度5° - 8° (6° 最常见) 传送带速度3.5 - 6.5 英尺/分钟 (1.0 - 1.8 米/分钟) 与焊料的接触时间 (包括晶片波和初级波) 1.5 - 3.5秒 (2½-3秒最常见) 焊槽温度460 - 500° f (235-260° c) 这些数据为一般性的指南，都已被证明能产生优异的结果；但是，由于设备、元件和电路板的差异，适合您的最佳设置可能有所不同。为了优化您的工艺，我们建议您进行实验设计，以优化最重要的可变因素 (如助焊剂用量、传送带速度、顶部预热温度、焊槽温度和电路板方向等)。助焊剂固体控制：如果是泡沫、波峰或旋转式滚筒喷雾焊接，必须通过稀释剂添加物对助焊剂固体进行控制，防止助焊剂溶剂的蒸发损失。对于固含量低于5%的任何助焊剂，比重不是评估和控制固体物质含量有效测量手段。要维持固体物质的含量，监测和控制溶液酸性值是值得建议的方法。溶液酸值应被控制在17 - 19。建议使用alpha助焊剂固含量控制3号工具箱 (一种数字滴定仪)。对于此工具箱工具滴定程序，请参阅alpha的技术资料sm - 458。在持续使用泡沫焊剂涂敷器时，应每隔2-4小时检查一次酸值。随着时间的过去，碎屑和污染物会堆积在循环助焊剂的喷头处。为保持焊接性能的稳定性，每运行40小时后放弃继续使用已用助焊剂。排空助焊剂后，应使用助焊剂稀释剂对存储器和泡沫石进行彻底清洗。

本产品的锡条是无铅助焊剂，型号是SLS65/SLS65C，品牌是阿尔法ALPHA，成份是松香乙丙醇，熔点是12 ()，适用范围是任何，焊点色度是亮，清洗角度是免清洗